2026年11月25日

各 位

会 社 名　　ＡＩメカテック株式会社
代表者名　　代表取締役執行役員社長　阿部　猪佐雄
（コード番号：6227 東証スタンダード）
問合せ先　　上席執行役員経営企画部長　米田　達也
（TEL 0297-62-9122）

大手半導体関連メーカーより大口受注のお知らせ

当社は、海外の大手半導体関連メーカーより、ウエハレベルパッケージ向けシステムを受注いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．今回の受注について

半導体製造工程においては、ＡＩ、５Ｇ、ＩｏＴ、及び自動運転市場などの成長を背景とした先端パッケージ技術の進化に対応すべく、更なるウエハの薄化・積層化が求められています。当該システムは、その薄化・積層化に対し重要なプロセスの一つを担っています。

当社では、長年培ってきたウエハの仮接合技術及び薄化後のウエハからサポートガラスを剥がし洗浄するプロセス技術にモノづくり力を融合した、高性能なウエハレベルパッケージ向けシステムを提案して参りました。その結果、これまでの取引実績も踏まえ、安定した品質と歩留まり向上を実現できる点が評価され、今般の受注に至りました。

２．受注内容

受注製品	ウエハレベルパッケージ向けシステム（テンポラリーボンダー・デボンダー装置）
受注金額	約60億円
売上計上予定	2028年６月期

３．業績への影響

当該受注は、2028年６月期に売上計上する見込みです。顧客との納期調整等により、今期業績予想に修正の必要が生じた場合は速やかに開示いたします。

なお、当該受注はすべて円建てとなっており、為替レートの変動による影響はありません。

（参考）当期業績予想及び前期実績　　（単位：百万円）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期業績予想（2027年６月期）	40,003	7,610	7,238	4,963
前期実績（2026年６月期）	35,244	5,810	5,636	3,560

以　上